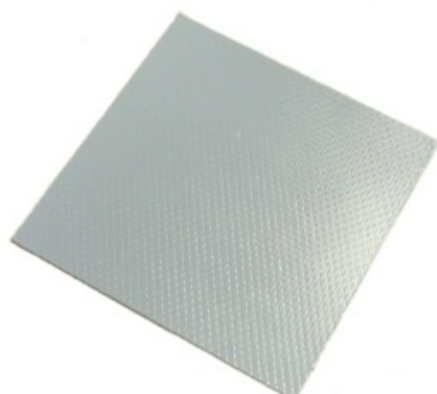
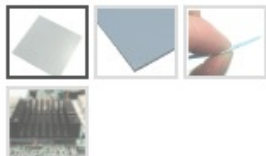



[製品カタログはこちら](#) →

[今すぐ購入](#) →

型番	WW-GAP-B05A
熱伝導率	1.4W/m・K
使用温度範囲	-40℃～150℃
寸法	100mm×100mm×厚さ0.5mm
JANコード	4524945013049

仕様	硬さ 5 JIS Type E 体積抵抗率 $\geq 1 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ 絶縁破壊電圧 $\geq 10 \text{ AC kV/mm}$ 耐電圧 $\geq 10 \text{ AC kV/mm}$ 難燃性 V-0 VL94 比重 1.8 絶縁性 装着に便利な片面粘着タイプ（二層タイプ） RoHS 2.0 適合 シリコン系基材
製品PR	基板等に貼る場合、グミのように非常に柔らかい素材ですので、装着表面が不均一でも全体の接触面をカバーし、それぞれの部品または基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。 ・熱源にシートを貼り、熱を逃がしたい放熱体・筐体に密着させ使用します。 ・（熱源と放熱体・筐体の間に挟んで使用します） ・発熱体とヒートシンク・放熱体とのすき間（ギャップ）や凹凸を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。 ・熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。 ・非常に柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。 ・用途、場所に応じた形状にカットし、使用できます。 ・素材の柔軟性を極限まで生かすことで、凹凸への追従性やクッション性を備えている為、高さの異なる部品への密着性が優れております。 ・公差の吸収など設計に有効に活用できます。 ・どちらの面が発熱側向け、放熱側向けとの決まりはございません。作業性を重視してお使い下さい。